COMPAL

3Q26暨1-3Q26合併財務報告

Compal Electronics, Inc.

日期: Nov 12, 2026

FROM VISION TO REALITY

Innovation Empowered

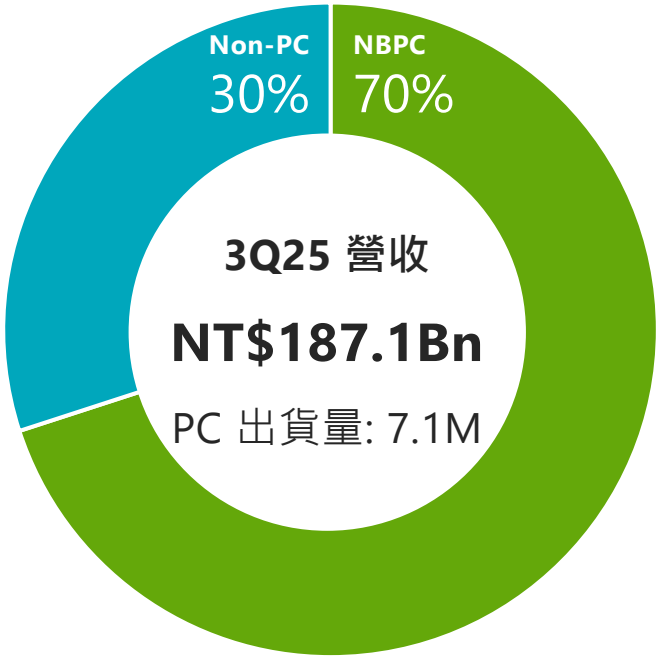
風險事項提醒

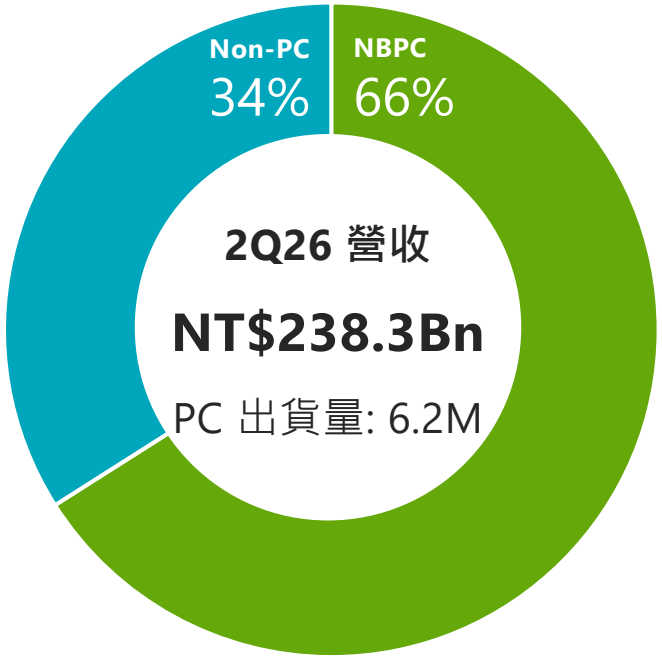
本簡報資料內容包括對公司未來營運之預測性資訊，該項預估存在未實現風險及不確定性。本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。

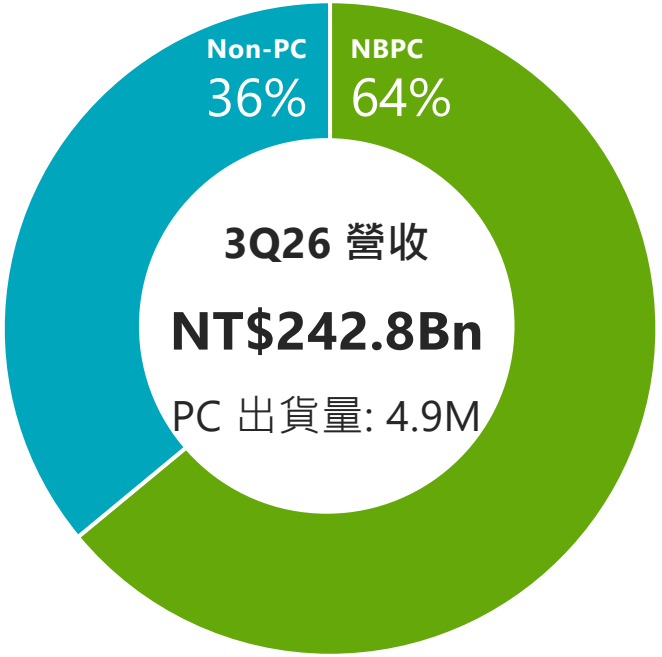
本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的預估，投資人不應將此預估解釋為具有法律約束力的承諾。未來展望若有任何變更或調整時，本公司並不負隨時提醒或更新之義務。

3Q26暨1-3Q26財務報告

季度營收組合


Non-PC
30%
NBPC
70%
3Q25 營收
NT$187.1Bn
PC 出貨量: 7.1M


Non-PC
34%
NBPC
66%
2Q26 營收
NT$238.3Bn
PC 出貨量: 6.2M


Non-PC
36%
NBPC
64%
3Q26 營收
NT$242.8Bn
PC 出貨量: 4.9M

3Q26合併綜合損益表

新台幣 百萬元	3Q26		2Q26		季成長	3Q25		年成長
營收淨額	**242,777**		**238,295**		**2%**	**187,120**		**30%**
營收毛利	**10,575**	**4.4%**	**11,021**	**4.6%**	**-4%**	**10,610**	**5.7%**	**0%**
營業費用	8,327	3.5%	8,166	3.4%	2%	7,938	4.3%	5%
營業淨利	**2,248**	**0.9%**	**2,855**	**1.2%**	**-21%**	**2,672**	**1.4%**	**-16%**
業外收支	1,673		1,784			545		
利息收入(支出)	(417)		105			169		
採用權益法利益(損失)	(220)		(264)			(102)		
匯兌收益(損失)	428		(190)			112		
其他	1,882		2,133			366		
稅前淨利	**3,921**	**1.6%**	**4,639**	**1.9%**	**-15%**	**3,217**	**1.7%**	**22%**
所得稅費用	872		1,030			768		
非控制權益	467		476			502		
母公司業主	**2,582**	**1.1%**	**3,133**	**1.3%**	**-18%**	**1,947**	**1.0%**	**33%**
基本每股盈餘(新台幣元)	**$ 0.61**		**$ 0.73**			**$ 0.45**		

註:除每股盈餘金額為新台幣元外，其餘數字為新台幣百萬元；財務資料係採IFRS編製基礎

1-3Q26合併綜合損益表

新台幣 百萬元	1- 3Q26		1- 3Q25		年成長
營收淨額	**682,376**		**566,661**		**20%**
營收毛利	**32,193**	**4.7%**	**31,639**	**5.6%**	**2%**
營業費用	24,446	3.6%	23,637	4.2%	3%
營業淨利	**7,747**	**1.1%**	**8,002**	**1.4%**	**-3%**
業外收支	3,904		(68)		
利息收入(支出)	(53)		191		
採用權益法利益(損失)	(748)		(439)		
匯兌收益(損失)	721		(97)		
其他	3,984		277		
稅前淨利	**11,651**	**1.7%**	**7,934**	**1.4%**	**47%**
所得稅費用	2,602		1,917		
非控制權益	1,367		1,396		
母公司業主	**7,682**	**1.1%**	**4,621**	**0.8%**	**66%**
基本每股盈餘(新台幣元)	**$ 1.78**		**$ 1.06**		

註:除每股盈餘金額為新台幣元外，其餘數字為新台幣百萬元；財務資料係採IFRS編製基礎

1-3Q26合併資產負債表

新台幣 百萬元	3Q26		2Q26		3Q25	
現金及約當現金	**83,986**	**14%**	**82,929**	**16%**	**73,408**	**18%**
應收票據及帳款	219,110	37%	212,051	41%	170,312	41%
存貨	168,878	28%	111,644	21%	83,384	20%
流動資產	485,659	82%	423,759	81%	345,773	83%
資產總計	**592,676**	**100%**	**521,783**	**100%**	**417,889**	**100%**
應付票據及帳款	183,777	31%	185,421	36%	157,553	38%
流動負債	411,786	69%	345,138	66%	259,108	62%
負債總計	**436,888**	**74%**	**368,221**	**71%**	**276,719**	**66%**
股東權益總計	**155,788**	**26%**	**153,562**	**29%**	**141,169**	**34%**
每股淨值-母公司(新台幣元)	**$ 31.7**		**$ 31.3**		**$ 28.8**	
應收帳款周轉天	82		81		83	
存貨週轉天	66		45		43	
應付帳款週轉天	72		74		81	
現金週轉天期	**76**		**52**		**45**	

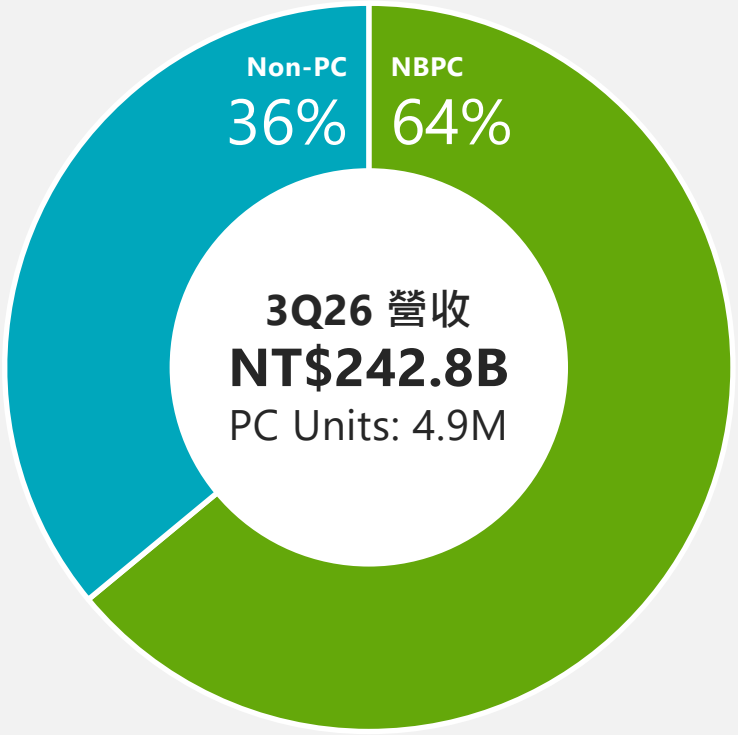
註:除每股淨值金額為新台幣元外，其餘數字為新台幣百萬元；財務資料係採IFRS編製基礎

營運近況與展望

3Q26營收亮點

營收

NT$242.8 Bn



	季增	年增
總營收成長	+2%	+30%
非 PC 營收成長	+8%	+60%
非 PC 營收占比	+2pp.	+6pp.

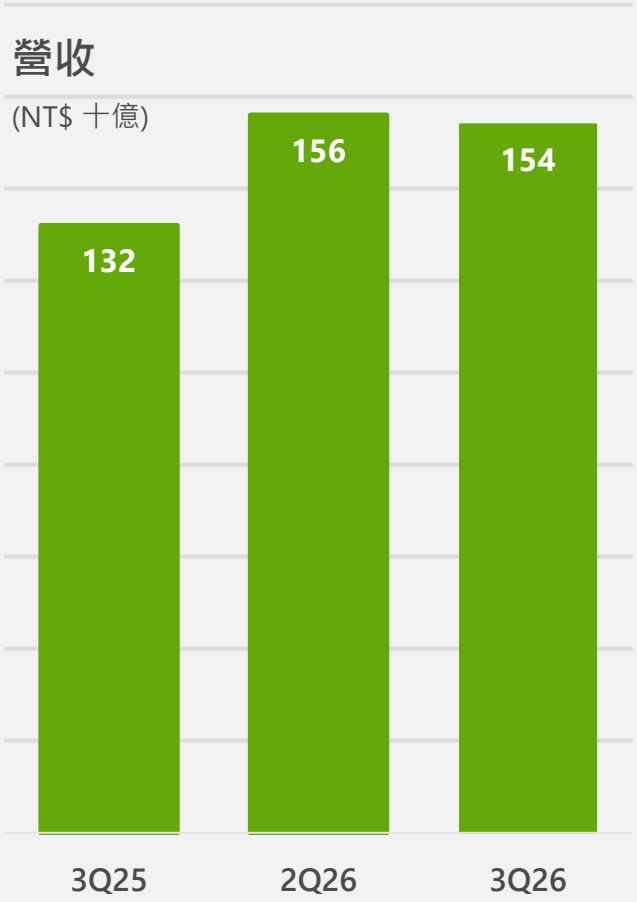
NB PC事業

NB PC 營收

NT$154 Bn

	季增	年增
	-1%	+17%

- 儘管 PC 出貨量季減 20%，平均銷售單價（ASP）提升，有效抵銷部分出貨量下滑的影響。
- 高階及 AI PC 出貨占比約 60%，持續帶動產品組合優化及 ASP 成長。
- 展望 2026 全年，受零組件供應限制及終端需求疲弱影響，PC 出貨動能仍面臨挑戰。



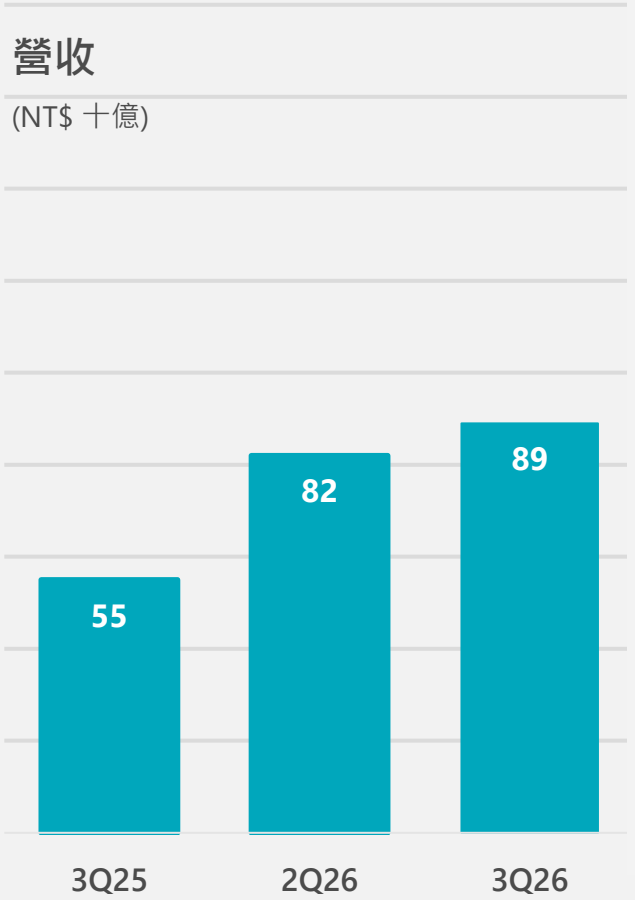
非PC事業

Non-PC 營收

NT$89 Bn

季增	年增
+8%	+60%

- 受惠於伺服器業務成長，非 PC 營收季增 8%、年增 60%，表現優於公司整體營收成長。
- 伺服器營收占比提升至低雙位數，其中 AI 伺服器占伺服器營收比重超過 80%。
- 公司持續朝中期非 PC 業務營收占比達 40% 的目標穩步邁進。



建立策略合作夥伴關係

COMPAL AI
AI Server

AI 伺服器

AI 伺服器 | 2026/09/01

HUMAIN攜手仁寶電腦深化AI策略合作 打造從雲端、邊緣到實體AI的完整布局



HUMAIN 選定仁寶為長期策略 ODM 合作夥伴，共同開發涵蓋雲端、邊緣運算及實體 AI 的基礎設施。雙方於 LEAP 2026 國際科技展展示合作成果，結合仁寶的研發與製造能力及 HUMAIN 的 AI 發展願景，推動可規模化部署的 AI 伺服器、AI PC，以及透過仁寶 PolyMedX 平台實現的智慧醫院應用.... (繼續閱讀)

AI 伺服器 | 2026/09/14

仁寶與 Exascale Labs 簽署合作意向書，共同打造資料中心級原生 800 VDC 驗證平台



雙方規劃整合 GPU 伺服器、液冷散熱及先進電力系統，打造資料中心級原生 800 VDC 驗證平台，測試次世代 AI 基礎設施的系統整合與運作效能。該平台將支援 800 VDC 架構驗證，協助未來量產準備及產業認證，並提供生態系合作夥伴部署前的共同測試與驗證環境.... (繼續閱讀)

AI 伺服器 | 2026/10/14

仁寶於OCP展示新世代NVIDIA平台 加速AI運算從架構到部署的落地速度



仁寶於 OCP Global Summit 2026 展示涵蓋 NVIDIA Blackwell Ultra、Rubin、Vera CPU 及 Spectrum-X 網路技術的次世代 AI 基礎設施。結合研發設計、液冷散熱、機櫃整合、系統驗證及製造能力，協助客戶加速部署。透過整合 GPU、CPU 及網路系統的完整產品組合，提供可規模化擴充的 AI 運算能力.... (繼續閱讀)

建立策略合作夥伴關係

COMPAL AI
AI Server

AI 伺服器

AI 伺服器 | 2026/10/22

Verda 與仁寶於 GTC Berlin 2026 擴大全球 AI 基礎設施合作



Verda 與仁寶擴大合作，加速 AI 基礎設施部署。結合 Verda 的雲端專業與仁寶在台灣及美國的工程與製造能力，雙方將加快部署速度並強化供應鏈韌性。仁寶的 NVIDIA Blackwell Ultra 平台將支援 Verda 擴充 AI 運算量能，雙方也將於 GTC Berlin 2026 展示合作成果....(繼續閱讀)

AI 伺服器 | 2026/10/27

仁寶與 ARC Cloud 建立策略合作夥伴關係，加速大規模 AI 基礎設施部署



仁寶與 ARC Cloud 於 2026 OCP 全球峰會簽署合作備忘錄（MOU），共同推動美國 AI 基礎設施發展，並探討規模最高達 100 MW 的資料中心建置藍圖。結合仁寶的 AI 伺服器與液冷技術，以及 ARC Cloud 在 GPU 基礎設施領域的專業，雙方旨在加速 AI 部署，掌握持續成長的 AI 基礎設施市場商機.... (繼續閱讀)

AI 伺服器 | 2026/11/10

從晶片到高速互連架構：仁寶於 SC26 串聯 NVIDIA 運算與網路技術



仁寶將於 SC26 展示採用 NVIDIA 技術的 AI 基礎設施，包括 HGX B300 伺服器、HGX Rubin NVL8 平台、MGX 系統、RTX PRO 加速運算技術，以及 Vera CPU 運算托盤。產品組合涵蓋氣冷與直接液冷伺服器、網路設備及機櫃級系統整合，支援企業應用與大規模分散式 AI 運算..... (繼續閱讀)

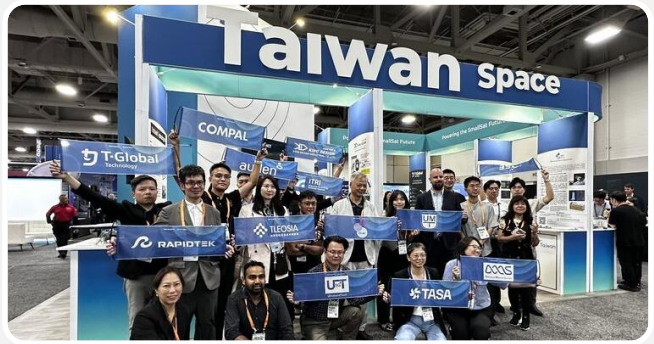
推動連網通訊的未來發展

COMPAL AI Intelligent Systems

智慧連結

智慧系統 : 智慧連結 | 2026/9/1

仁寶於 SmallSat 2026 展示衛星技術實力



仁寶參與於美國猶他州舉行的 SmallSat 2026，進駐首度設立的「TAIWAN SPACE 台灣太空館」，展示通訊酬載、使用者終端、電子掃描天線及系統整合能力。以「驅動小衛星未來」為主題，仁寶與產業專家及潛在合作夥伴交流，提升台灣在全球小衛星生態系中的能見度.....(繼續閱讀)

智慧系統 : 智慧連結 | 2026/9/18

仁寶將取得鋐寶全數股權，強化邊緣 AI 與連網通訊業務



仁寶與鋐寶董事會已通過以每股新臺幣 18.50 元進行現金股份轉換，使鋐寶成為仁寶全資子公司。此交易旨在整合網通技術能力、強化邊緣 AI 與連網通訊解決方案，並提升營運效率。交易完成後，鋐寶將自臺灣證券交易所下市，以利集團更靈活配置資源，深化旗下企業間的合作....(繼續閱讀)

智慧系統 : 智慧連結 | 2026/9/24

仁寶參與 2026 台北 6G 峰會，探索次世代連網通訊



仁寶與產業領袖及技術專家齊聚 2026 台北 6G 峰會，共同探索「AI 原生 6G 時代」。討論議題涵蓋 AI 驅動網路、頻譜、感測、衛星通訊及標準制定。秉持「連結世界的引擎」理念，仁寶積極與產業生態系交流，探索未來連網通訊的全新可能.....(繼續閱讀)

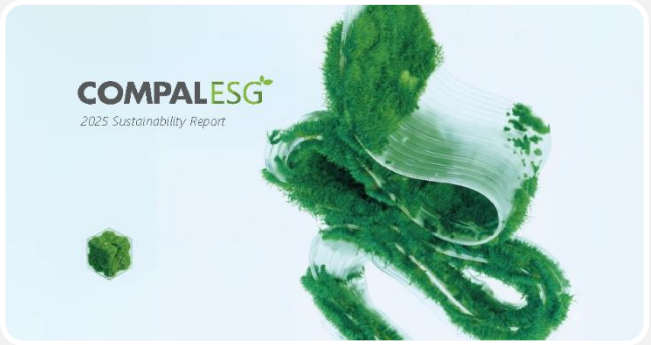
推動 AI 創新與永續發展

COMPAL AI
AI & ESG Transformation

AI & ESG 轉型

AI & ESG 轉型 | 2026/8/18

碳排放年減 33.5%，加速價值鏈淨零轉型



仁寶《2025 永續報告書》展現公司在治理、氣候行動、創新及共融方面的進展，持續邁向 2050 年淨零排放目標。個體邊界內的範疇一及範疇二排放量較前一年減少 33.5%，再生能源使用占比達 57.2%。仁寶並於標普全球企業永續評鑑（S&P Global CSA）獲得 89 分，名列《2026 永續年鑑》產業前 5%... (繼續閱讀)

AI & ESG 轉型 | 2026/10/01

仁寶 AI 轉型成果榮獲第六屆數位轉型鼎革獎雙項殊榮



仁寶於第六屆「數位轉型鼎革獎」榮獲兩項殊榮：「智造之眼」AI 視覺檢測平台獲得首獎，「AI 智能體賦能員工」獲得優選獎。這些解決方案有助於提升檢測品質與效率、簡化作業流程，並推動 AI 在製造與企業管理領域的應用... (繼續閱讀)



FROM VISION TO REALITY

Innovation Empowered